

通导基带芯片

Communication and navigation baseband chip

华力创通研发的卫星移动通信系列芯片采用SOC架构，采用先进的工艺设计，具有低功耗、集成度高、功能组件全的特点。芯片集成天通卫星移动通信、北斗/GPS定位为一体，实现通信和导航一体化设计。

型号		
	民用通导基带芯片 HTD1001	军用通导基带芯片 HTD2001
支持模式	天通卫星移动常规通信模式、BDSB1、GPSL1	天通卫星移动常规、集群、抗干扰、应急救生通信模式，BDS B1、GPS L1
工艺	40nm	40nm
标准通信接口	SPI、UART、GPIO、I2C、I2S、SD、LCD	SPI、UART、GPIO、I2C、I2S、SD、LCD
封装方式	LFBGA	LFBGA
尺寸	13mm × 13mm × 3mm	16mm × 16mm × 3mm
工作温度	-40°C ~+85°C	-40°C ~+85°C